



Ampoc Far East Co., Ltd.

揚博科技股份有限公司
Ampoc Far-East Co., Ltd.

股票代號：2493



2021/04/14



- 一、公司簡介
- 二、公司沿革
- 三、產業應用與產品介紹
- 四、財務資訊
- 五、未來展望





一、公司簡介

公司名稱	揚博科技股份有限公司
地址	台北市松德路171號17樓
電話	(02)2726-2220
董事長	蘇勝義 先生
總經理	喬鴻培 先生
資本額	新台幣 114,437 萬元
設立日期	1980年11月1日
員工人數	280人
公司網站	www.ampoc.com.tw



蘇勝義先生



二、公司沿革

AMPOC's History



2019/01

• 透過香港子公司投資 Ampec Trading (Shanghai) Co., Ltd.。

2006/12

• 吸收合併百分之百持有之揚鑫投資股份有限公司，合併後資本額不變。

2002/01

• 經證管會核准於 2002/1/23 股票掛牌上市，代號 2493。

2001/06

• 申請公司名稱變更為「揚博科技股份有限公司」，盈餘轉增資，股本增加為 90,500 萬元。

2000/10

• 辦理現金增資 4,800 萬元、盈餘轉增資 3,997 萬元、合併資本公積轉增資 7,424 萬元、員工紅利轉增資 401 萬元，增資後資本額為新台幣 73,729 萬元。

1999/12

• 合併台北化工機械股份有限公司，並增資發行新股 21,107 仟股，股本增為 57,107 萬元。

1998/12

• 獲准成為公開發行公司，辦理盈餘轉增資 10,200 萬元，增資後資本額為新台幣 30,000 萬元。

1998/03

• 設立精密儀器檢測服務實驗室，加強對客戶服務內容與品質。

1997/03

• 購置並遷入台北市松德路 171 號 17 樓之新辦公室。

1987/05

• 日本 TCM 於中壢工業區設立台北化工機械股份有限公司，產製 PCB 濕製程設備，本公司除參與投資外並取得日本以外全球獨家銷售權。

1980/11

• 揚博企業股份有限公司成立，股本 100 萬元。



三、產業應用與產品介紹

□ 產業應用

- 半導體前段
- 先進封裝製程
- 5G/AI

□ 產品介紹

- Laser Heater TC Bonder
- ABF Ampoc Wing 蝕刻系統



Ampoc Far East Co., Ltd.



產業應用





產業應用-核心發展策略

- ✓ 覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液。
- ✓ 3D-IC · FOWLP 高速電鍍藥水。
- ✓ 晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液。
- ✓ 高解析光阻液。
- ✓ Hard Mask

半導體
前段

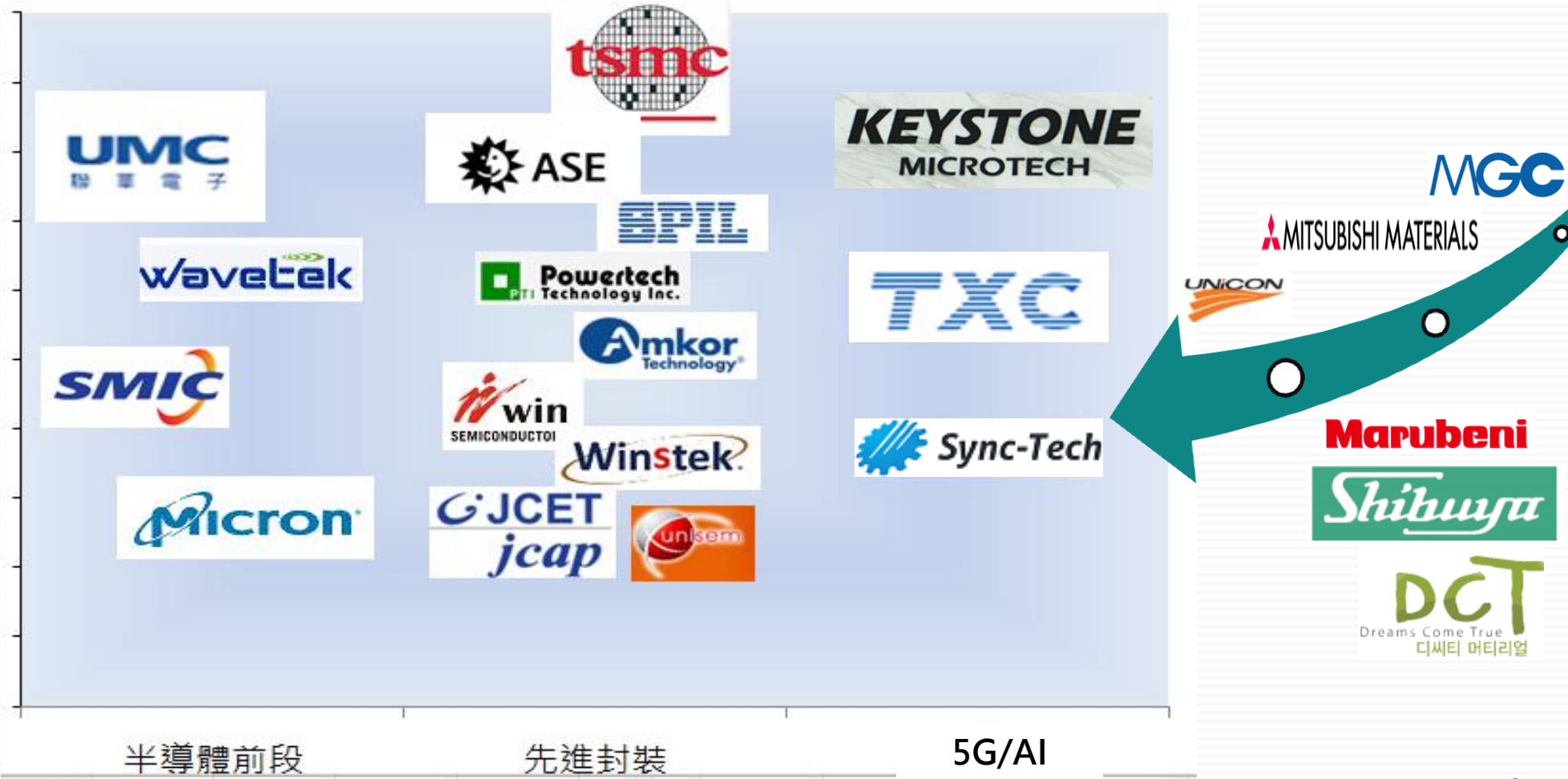
先進
封裝

- ✓ 導線架 metal finish 用藥水
- ✓ QFN導線架&石英震盪器電著光阻
- ✓ 5G通訊晶片測試MLO探針卡
- ✓ Bonder

5G/AI

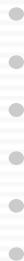
- ✓ 封裝天線良率檢測裝置
- ✓ AiP應用

主要客戶群與合作夥伴

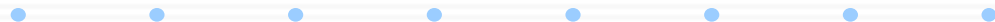




Ampoc Far East Co., Ltd.



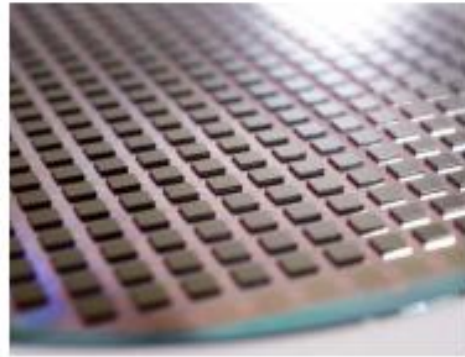
產品介紹





Ampoc Far East Co., Ltd.

Laser Heater TC Bonder

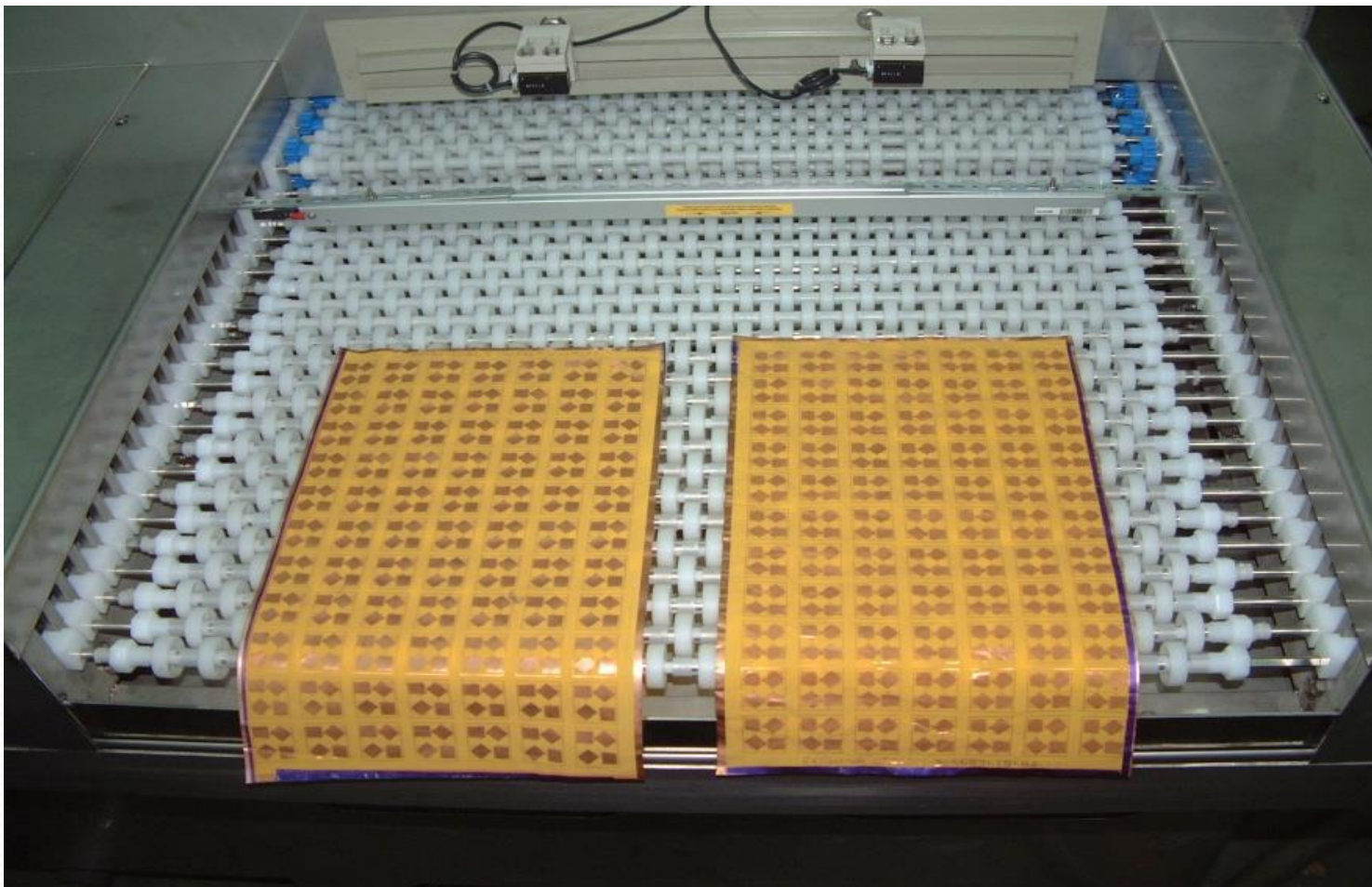


- Fast heating and cooling
- Low thermal expansion
- Localized heating





傳統水平式設備：板面接觸滾輪造成刮傷與汙染問題





Ampoc Far East Co., Ltd.

ABF載板垂直蝕刻系統 (Ampoc Wing)





四、財務資訊

最近年度綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	107年度	108年度 (合併)	109年年度 (合併)
營業收入		2,400,520	2,482,446	2,600,664
營業毛利		765,833	653,556	687,947
毛利率(%)		31.90	26.33	26.45
營業利益		423,229	354,944	397,524
稅後淨利		342,985	228,519	308,769
每股盈餘(元)		3.00	2.00	2.70



最近年度資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	107年	108年 (合併)	109年 (合併)
流動資產		2,713,049	2,660,223	2,951,161
非流動資產		758,096	708,293	697,883
資產總額		3,471,145	3,368,516	3,649,044
流動負債		938,712	892,531	1,141,638
非流動負債		108,930	126,181	153,401
負債總額		1,047,642	1,018,712	1,295,039



最近年度財務分析

項目	年度	107年	108年 (合併)	109年 (合併)
負債佔資產比 (%)		30.18	30.24	35.49
流動比率(%)		289.02	298.05	258.50
存貨周轉率(次)		1.89	2.19	2.08
權益報酬率(%)		14.66	9.57	13.13



110年度營收

單位：新台幣仟元

項目	月份	1月	2月	3月
金額		245,760	272,557	248,287
月增率(%)		-17.26	10.90	-8.90
年增率(%)		16.81	43.44	20.64



五、未來展望

2021年市場狀況與未來展望

2021上半年全球經濟持續受到新冠肺炎疫情影响加上地緣政治及匯率因素對未來市場仍有不確定性，所幸各國開始展開新冠疫苗施打，下半年開始疫情對於經濟的影響可望下降，同時可以觀察到從2020第四季開始全球各產業明顯復甦，半導體產業相關需求仍持續強勁，未來5G、AI與自駕車等應用將驅動半導體持續成長，因此對於2021年市場狀況預測仍是穩健成長。

揚博於多年的電子業經驗下，保有硬體上的優勢及完整的上下游供應鏈，揚博代理部份秉持著多年於電子業界的經營理念，仍以審慎的態度持續耕耘，主要客戶為求供貨穩定持續拉貨，營運動能穩健成長，未來將持續積極佈局半導體前段、先進封裝、5G通信/AI人工智能此三大方向，創造營運新一波動能。



台灣PCB產業2020年回顧及2021年展望

- 一. 2020年全球電路板產值預估達到美金625億。台商兩岸PCB產業產值達6,963億新台幣(約為236.09億美元)，較2019年的6,624億新台幣相比成長5.1%。
- 二. 台灣在全球市場占有率奪冠，惟中國大陸的占比也持續成長的國家，其中最大關鍵就是5G、大數據、雲端計算、人工智能、物聯網、自駕車等行業快速發展，使其市占率和成長率正快速上升中。
- 三. 2021年預估PCB擴充產能其產品包含5G相關載板、HDI、軟板，應用市場包含智慧型手機、汽車電子、物聯網、網通等產品市場。
- 四. 2021年設備需求觀察重點：
 1. ABF載板高階製程設備需求。
 2. 各PCB廠跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板、HDI、軟板設備需求。
 3. 電動汽車與安全相關PCB設備需求。



Ampoc Far East Co., Ltd.



Thank you
The End

